



平成 21 年 9 月 24 日

各 位

会 社 名 ザインエレクトロニクス株式会社
代表者の役職名 代表取締役社長 飯塚 哲哉
(JASDAQ・コード番号：6769)
問 い 合 わ せ 先 取締役経営企画部長 高田 康裕
電 話 番 号 0 3 - 3 2 7 0 - 0 6 6 6

ISP 事業統合完了に伴う子会社の解散のお知らせ

当社は、本年 1 月 20 日に画像処理用 LSI (ISP: Image Signal Processor) の事業譲受を行いました。その後の当社への事業統合を順調に進め計画よりも早期に完了することができました。ISP 事業統合の完了に伴い、平成 21 年 9 月 24 日開催の取締役会におきまして、事業譲受を行うための子会社であったザイン・イメージング・テクノロジー株式会社を解散することを決議しましたので、お知らせいたします。

1. ISP 事業統合完了に伴う解散理由

ザイン・イメージング・テクノロジー株式会社は、台湾 Winbond Electronics Corporation からの画像処理用 LSI 事業 (ISP 事業 : Imaging Signal Processor 事業) の譲受けのために設立され、当社が本年 1 月 20 日に譲受け、その後、当社企業グループの新事業として立ち上げる活動を行ってまいりました。既にお客様に 800 万画素、500 万画素および 300 万画素の新製品を含む ISP 製品を提供してきたほか、今後の成長に向けた新製品開発のためのプロジェクトを複数開始できる状況に至りました。譲受後の事業の順調な立ち上げを受けて、ISP 事業を当社に事業統合する計画を大幅に繰り上げて本年 7 月 1 日付で ISP 開発チームを当社に統合するとともに、資産の当社への移管が完了したことにより、譲受会社である当該子会社の役割が終了したため解散を決定いたしました。

2. 解散する子会社

(1) 名 称	ザイン・イメージング・テクノロジー株式会社
(2) 所 在 地	東京都中央区日本橋本町 3-3-6
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 加藤 雅弘
(4) 事 業 内 容	半導体企画・設計・製造・販売
(5) 資 本 金	1,000 千円
(6) 設 立 年 月 日	平成 20 年 7 月 23 日
(7) 大株主及び持株比率	当社 100%

3. 解散及び清算の日程

平成 21 年 10 月 6 日 当該子会社における臨時株主総会決議による解散決議 (予定)
平成 21 年 12 月下旬 清算終了 (予定)

4. 今後の見通し

特段の影響はありません。

以上